



PCIM Europe 2018, Norimberga - Hall 9 - Stand 301

Toshiba sviluppa degli IEGT da 4,5 kV in formato press-pack con migliore resistenza alla rottura

Il nuovo formato del package assicura una resistenza alla rottura 1,7 volte più elevata rispetto ai package tradizionali in formato press-pack

Düsseldorf, Germania, 29 Maggio 2018 – Toshiba Electronics Europe fornirà dettagli sul nuovo package per i propri dispositivi IEGT da 4,5 kV in formato press-pack (PPI) in occasione di PCIM 2018 a Norimberga. Il nuovo package è stato sviluppato per migliorare ulteriormente la resistenza alla rottura del dispositivo, riducendo così la probabilità che si verifichino danni ai componenti e ai sistemi circostanti in caso di guasto al dispositivo.

Il package è il risultato delle ricerche condotte per valutare il rapporto di volume ottimale dei materiali al suo interno. Tale rapporto è stato determinato attraverso la sperimentazione, durante la quale non si sono verificate né la distruzione della ceramica, né perdite di materiale.

In seguito a misurazioni accurate, il package si è rivelato in grado di sopportare 50 ore di modalità di guasto (SCFM) di cortocircuito. L'esperimento è stato eseguito con un chip IEGT

cortocircuitato ogni 42 chip IEGT, in una posizione marginale corrispondente al caso peggiore.

Inoltre, i test di resistenza alla rottura, effettuati in una condizione di test a 3200 V, hanno fornito valori di resistenza superiori di 1,7 volte rispetto a quelli dei dispositivi PPI standard.

I risultati della ricerca saranno presentati da Raita Kotani e Georges Tchouangue Giovedì 7 giugno alle 11:15 alla Conferenza PCIM Europe 2018.

###

Informazioni su Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe GmbH](#) (TEE) è la divisione Europea dedicata alla produzione di componenti elettronici di [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre ai consumatori e alle aziende Europee un'ampia varietà di unità a disco rigido (HDD), oltre a soluzioni su semiconduttore per applicazioni automotive, industriali, IoT, per il controllo del movimento, telecom, di rete, consumer e per gli elettrodomestici. Il vasto portafoglio di prodotti della società comprende IC wireless integrati, semiconduttori di potenza, microcontrollori, semiconduttori ottici, ASIC, ASSP e dispositivi discreti che vanno dai diodi agli IC logici.

Fondata nel 1973 a Neuss in Germania, TEE ha sede principale a Düsseldorf in Germania, con filiali in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia e nel Regno Unito con attività di progettazione, produzione, marketing e vendite. Il presidente della compagnia è il sig. Akira Morinaga.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all'indirizzo www.toshiba.semicon-storage.com.

Indirizzo di riferimento da pubblicare:

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

E-mail: discrete-ic@toshiba-components.com

Contatto per i giornalisti:

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe GmbH

Tel: +44 (0)193 282 2832

E-mail: MShrimpton@teu.toshiba.de

Comunicato emesso da:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0) 20 8429 6554

Web: www.publitek.com

E-mail: birgit.schoeniger@publitek.com

Maggio 2018

Rif. 7132/A